

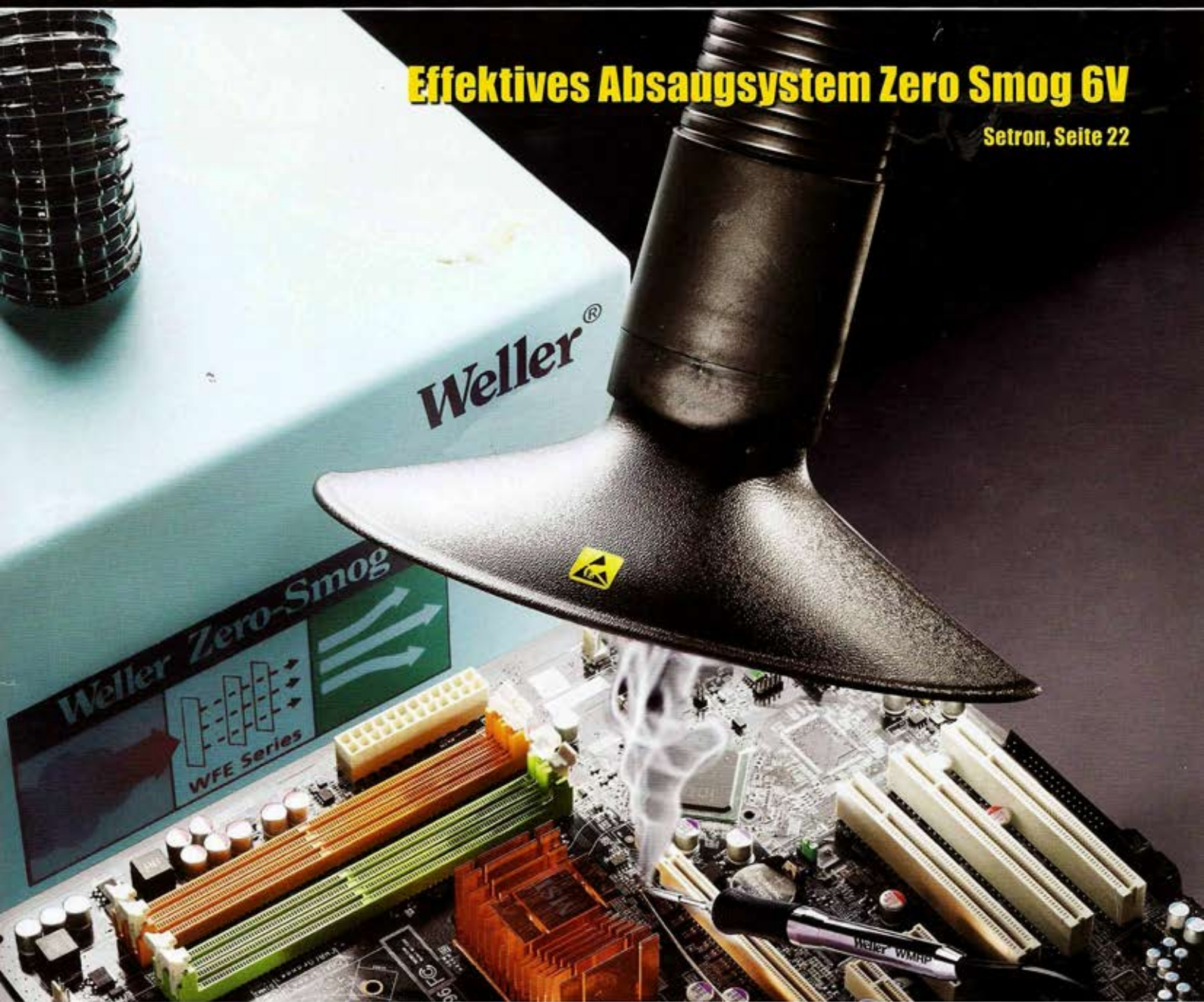
April/Mai/Juni 2/2013

electronicfab

Fachzeitschrift für Elektronik-Produktion

Effektives Absaugsystem Zero Smog 6V

Setron, Seite 22



In diesem Heft:

**Sonderteil
Einkaufsführer Elektronik-
Produktion 2013** ab Seite 41

Automatisierung der Fertigung



Die Produktion von Leiterplatten ist ein komplexer Prozess, der von der Beschaffung der Rohmaterialien bis zur Montage und Prüfung der fertigen Bauteile reicht. In diesem Bereich spielen Automatisierungslösungen eine zentrale Rolle, um die Effizienz und Qualität der Fertigung zu steigern. Insbesondere bei der Montage von SMD-Komponenten und bei der Durchführung von Laserlötlösungen sind spezialisierte Maschinen gefragt.

Die Entwicklung neuer, flexibler Fertigungslösungen ist für die Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung. Dies ermöglicht die Herstellung von Kleinserien und individuellen Bauteilen wirtschaftlich. Die Integration von Robotik und Automatisierungstechnik in die Fertigungslinien ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg moderner Elektronikhersteller.

Firmen stellen sich vor:



Innovative Lösungen für die Elektronikfertigung

Osai Automation Systems wurde 1991 mit dem Ziel, Sondermaschinen für die Montage und Prüfung von Komponenten für die Automobil-, Elektro- und Elektromechanische Industrie zu fertigen, gegründet.

Heute ist das Unternehmen mit seinen drei Geschäftsfeldern Sondermaschinen, Standard-Maschinen für die Elektronikfertigung und Standard- und Sondermaschinen für die Laserbearbeitung einer der Marktführer in Italien.

Insbesondere die Erfolge der Produktfamilie neoseries, die der Elektronik- und Halbleiterindustrie ein breites Spektrum an innovativen Automatisierungslösungen bietet, hat Osai Automation Systems zum Anlass genommen, Ende 2009 die deutsche Tochtergesellschaft Osai Automation Systems GmbH zu gründen. Mit dieser Maßnahme wurde die Präsenz auf dem deutschen Markt verstärkt.

Die neo-Plattform wurde entwickelt, um für die Elektronik- und Halbleiterindustrie ein breites Spektrum an Fertigungsequipment zur Verfügung zu stellen. Insbesondere für die Prozesse, die heute häufig manuell ausgeführt werden oder auf komplexen Produktionslinien nur unrentabel zu realisieren sind. Es werden Standardlösungen für die Prozesse Laserbeschriften, Bestücken (insbesondere PTH/THT und Odd-Shape-Components), selektives Laserlöten, Leiterplattenvereinzeln, Trimmen, Testhandler, Bauteilzuführung und Leiterplattenhandling angeboten. Osai Automation Systems bietet technisch und wirtschaftlich interessante Standard- und kundenspezifische Lösungen.



Besuchen Sie uns auf der SMT Hybrid Packaging vom 16. - 18.04.2013 in Nürnberg, Stand 6-416.